



## Neue Oberseitenkühlungstechnologie von NXP verkleinert 5G-Sendeanlagen

- *Die neue Gehäusetechnologie von HF-Verstärkermodule mit einer Kühlung von der Oberseite ermöglicht kleinere, dünnere und leichtere Funkmodule, was die Installation von 5G-Basisstationen vereinfacht und beschleunigt*
- *Vereinfachte Entwicklung und Fertigung ohne Leistungseinbußen*

**Eindhoven, Niederlande, 6. Juni 2023 (GLOBE NEWSWIRE)** --- NXP Semiconductors (NASDAQ: NXPI) bringt eine neue Produktfamilie von HF-Verstärkermodule mit Oberseitenkühlung auf den Markt. Deren innovative Gehäusetechnik ermöglicht schlankere und leichtere Sendeanlagen für die 5G-Infrastruktur. Die kleineren Basisstationen lassen sich einfacher und kostengünstiger installieren und fügen sich zudem unauffälliger in ihre Umgebung ein. Die GaN-Multi-Chip-Modulserie von NXP in Kombination mit der branchenweit ersten Kühllösung für das HF-Verstärkermodul auf der Oberseite reduzieren die Bauhöhe und das Gewicht des Funkmoduls um mehr als 20 Prozent. Dadurch verringert sie auch den CO<sub>2</sub>-Fußabdruck bei Herstellung und Installation von 5G-Basisstationen.

„Die Oberseitenkühlung eröffnet große Chancen für Hersteller der Telekommunikationsinfrastruktur, da sie hohe Ausgangsleistung mit verbesserter thermischer Leistungsabgabe kombiniert. Das erlaubt die Entwicklung kleinerer Funk-Subsysteme“, sagt Pierre Piel, Vice President und General Manager Radio Power bei NXP. „Diese Innovation unterstützt also nicht nur den Einsatz umweltfreundlicherer Basisstationen, sie ermöglicht gleichzeitig auch die erforderliche Netzdichte, um die Leistungsvorteile von 5G voll auszuschöpfen“.

Die neuen HF-Verstärkermodule mit Oberseitenkühlung von NXP bieten erhebliche Vorteile bei Entwicklung und Fertigung, wie zum Beispiel den Wegfall der dedizierten HF-Abschirmung. Weitere Pluspunkte sind die Verwendung einer kostengünstigen und optimierten Leiterplatte sowie eine Trennung des Wärmemanagements vom HF-Design. So können Anbieter von Netzwerklösungen äußerst schlanke und leichte 5G-Funkmodule für Mobilfunknetzbetreiber entwickeln und dabei gleichzeitig ihre Entwicklungszyklen verkürzen.

NXPs erste HF-Verstärkermodulserie mit Oberseitenkühlung ist für 32T32R, 200-W-Funksysteme für 3,3 GHz bis 3,8 GHz ausgelegt. Die Produkte kombinieren die firmeneigenen LDMOS- und GaN-Halbleitertechnologien, um eine hohe Verstärkung und einen hohen Wirkungsgrad mit breitbandiger Leistung zu erzielen. Sie bieten eine Verstärkung von 31 dB und einen Wirkungsgrad von 46 Prozent bei einer momentanen Bandbreite von 400 MHz.

Die Produkte A5M34TG140-TC, A5M35TG140-TC und A5M36TG140-TC sind ab sofort verfügbar. Der A5M36TG140-TC wird von der RapidRF-Referenzboard-Serie von NXP unterstützt. Für weitere Informationen über die Produktfamilie laden Sie bitte das Fact Sheet unter [NXP.com/TSCEVBFS](https://www.nxp.com/TSCEVBFS) herunter oder wenden Sie sich an den weltweiten NXP-Vertrieb.

###

### Über NXP Semiconductors

NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ: NXPI) bringt kluge Köpfe zusammen, um wegweisende Technologien zu entwickeln, die die vernetzte Welt besser, zuverlässiger und sicherer machen. Als ein weltweit marktführendes Unternehmen bei Lösungen für sichere Kommunikation in Embedded-Applikationen treibt NXP Innovationen in den Anwendungsfeldern Automobiltechnik, Industrie & IoT, bei Mobilgeräten und Kommunikationsinfrastruktur voran und fördert mit seinen Lösungen eine nachhaltigere Zukunft. Das Unternehmen, das auf die Erfahrung und Expertise von mehr als 60 Jahren



bauen kann, beschäftigt ca. 34.500 Mitarbeitende in mehr als 30 Ländern und erzielte 2022 einen Umsatz von 13,21 Milliarden US-Dollar. Weitere Details unter [www.nxp.com](http://www.nxp.com).

NXP und das NXP-Logo sind eingetragene Warenzeichen von NXP B.V. Alle anderen Produkt- oder Dienstbezeichnungen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Alle Rechte vorbehalten. © 2023 NXP B.V.

**Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:**

**Amerika & Europa**

Andrea Lempart

Tel: +49 175 610 695 1

Email: [andrea.lempart@nxp.com](mailto:andrea.lempart@nxp.com)

**China / Asien**

Ming Yue

Tel: +86 21 2205 2690

Email: [ming.yue@nxp.com](mailto:ming.yue@nxp.com)